

2017年3月期（2016年4月～2017年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2017年4月28日

内容：

- 2017年3月期 連結決算の概要
- 事業ハイライトおよび業績予想

代表取締役専務執行役員 堀 哲朗

代表取締役社長・CEO 河合 利樹



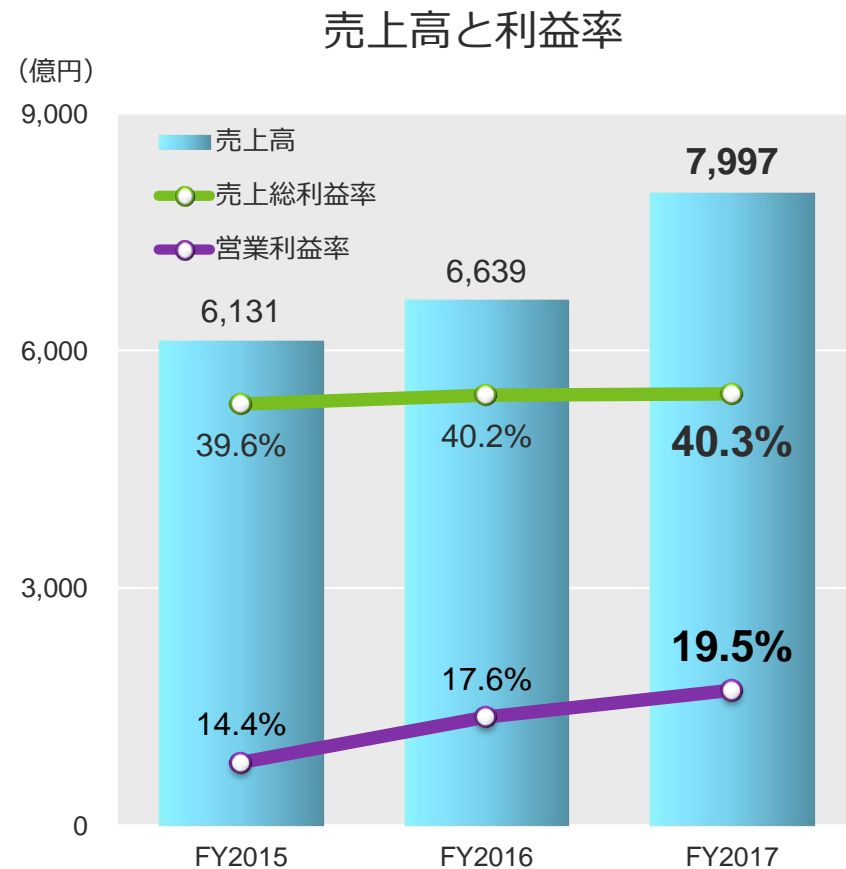
2017年3月期 連結決算の概要

2017年4月28日

堀 哲朗
代表取締役専務執行役員



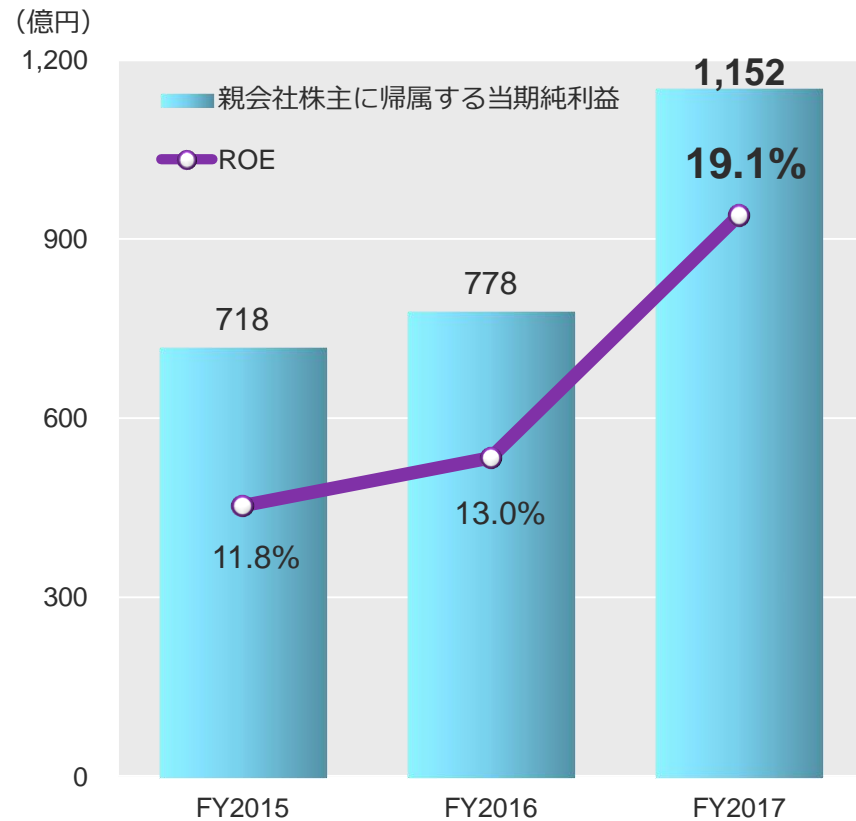
2017年3月期 決算ハイライト



- **連結売上は前年比+20%の増収、SPE売上高は過去最高を記録**
- **売上総利益率・営業利益率ともに過去最高を更新**

2017年3月期 決算ハイライト

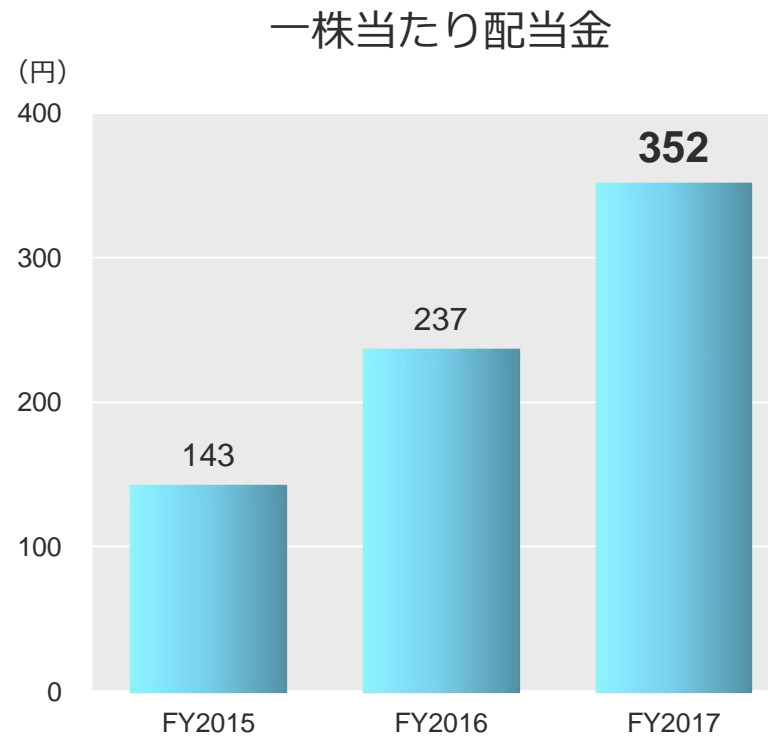
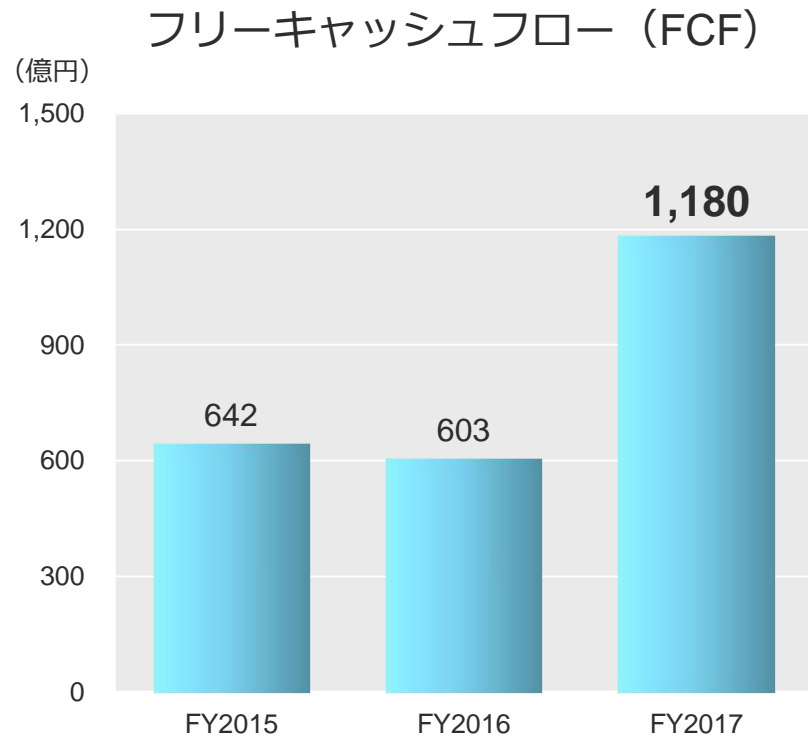
親会社株主に帰属する当期純利益とROE



ROE = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 x 100

- 当期純利益は過去最高を達成
- ROEは19.1% (前期比+6.1pts)
資本効率がさらに向上

2017年3月期 決算ハイライト



フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー +
投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

**前期比約2倍となる1,180億円のFCFを創出
一株当たり配当金は3期連続で過去最高を更新**

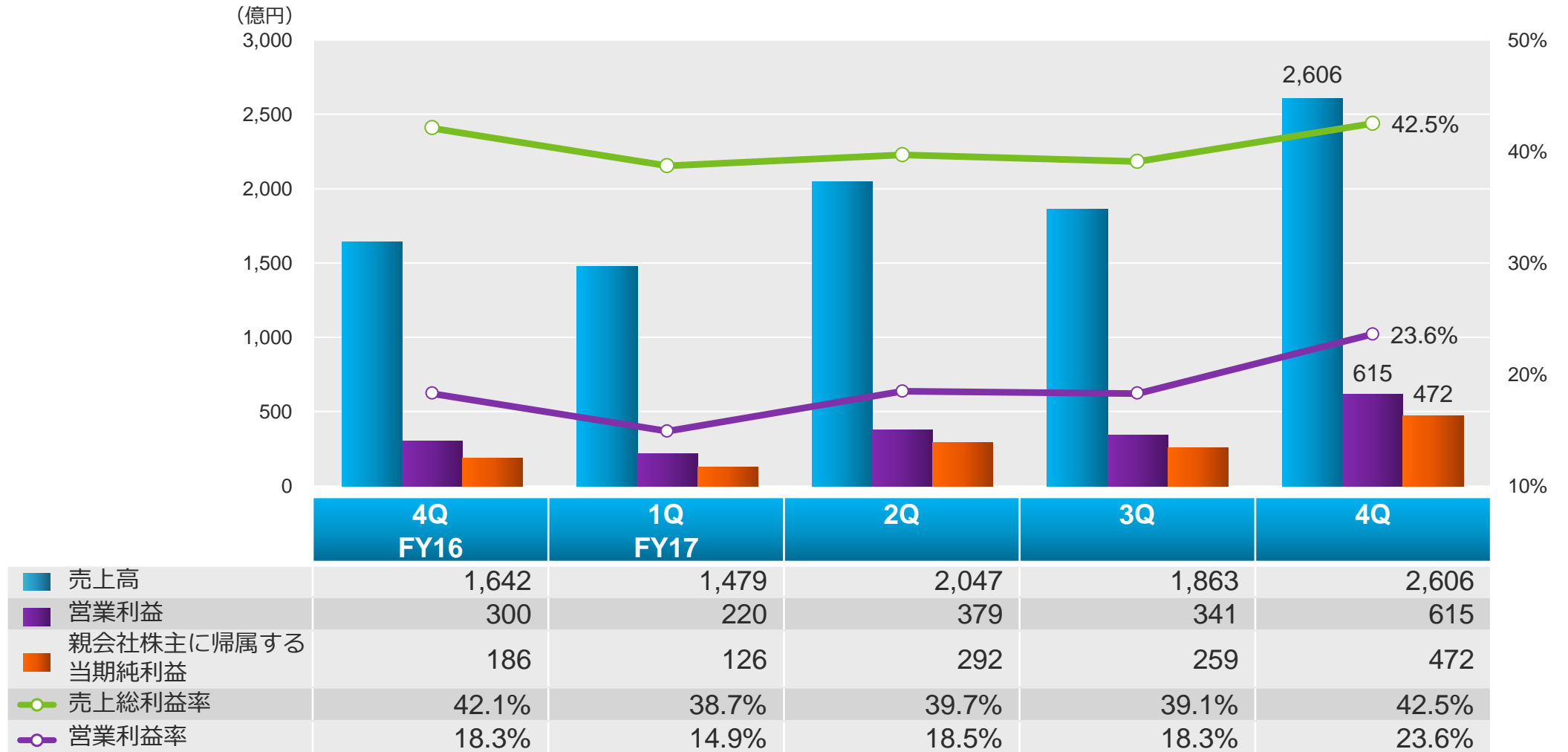
損益状況

(億円)

	2016年3月期	2017年3月期	対前年 増減率	(ご参考) 10/28に発表の 2017年3月期予想
売上高	6,639	7,997	+20.4%	7,620
売上総利益 下段：売上総利益率	2,672 40.2%	3,222 40.3%	+20.6% +0.1pts	
販管費	1,504	1,665	+10.8%	1,640
営業利益 下段：営業利益率	1,167 17.6%	1,556 19.5%	+33.3% +1.9pts	1,400 18.4%
税前利益	1,064	1,491	+40.1%	1,340
親会社株主に帰属する 当期純利益	778	1,152	+47.9%	1,000
1株当たり当期純利益	461.10	702.26	+52.3%	609.56
研究開発費	762	838	+9.8%	840
設備投資額	133	206	+55.1%	250
減価償却費	192	178	-7.2%	190

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

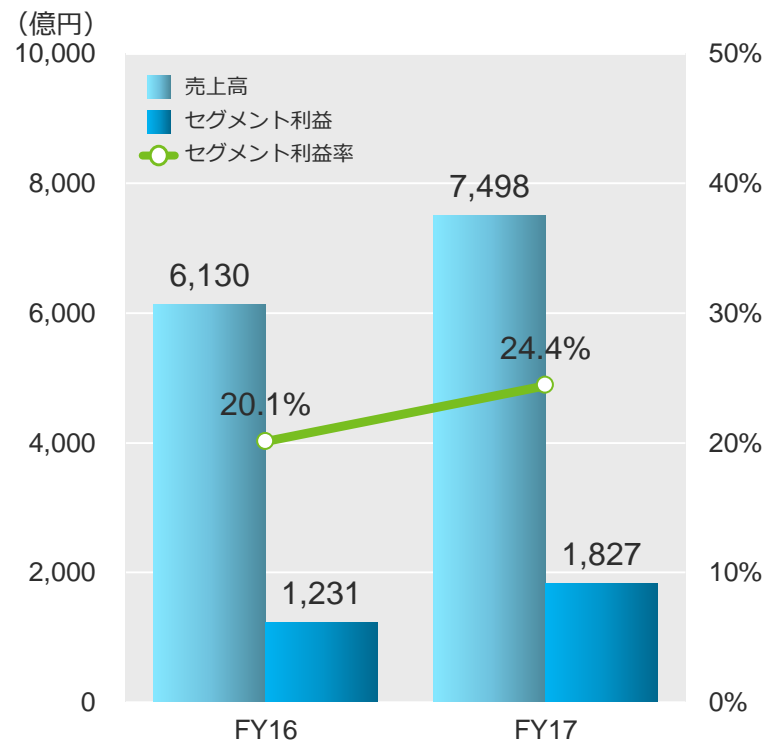
損益状況 (四半期)



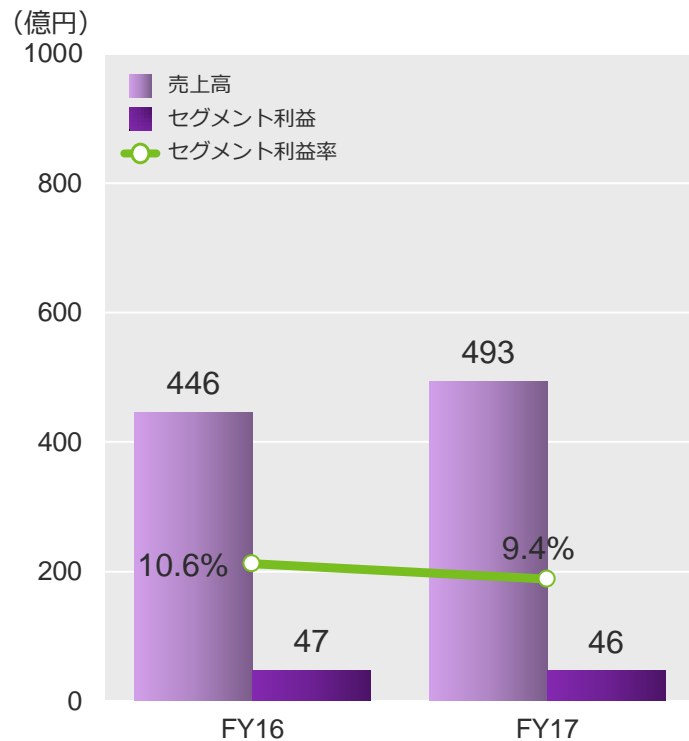
四半期ベースで営業利益率は過去最高の23.6%

セグメント情報

SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



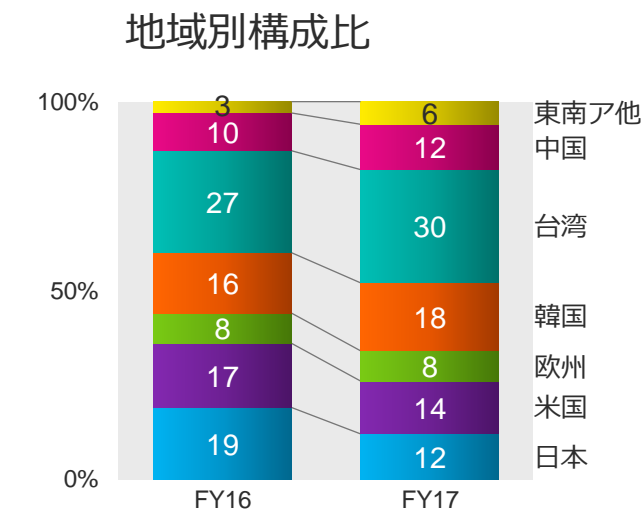
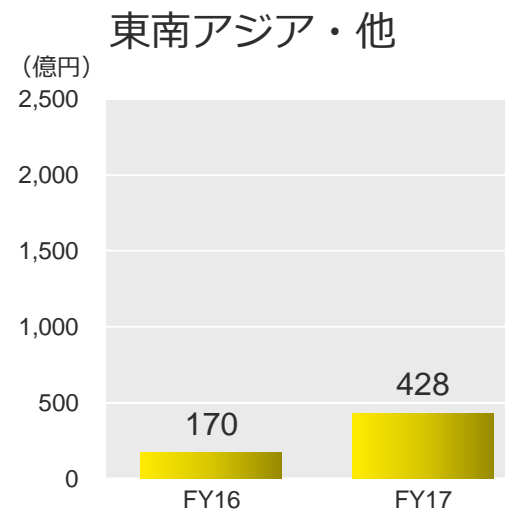
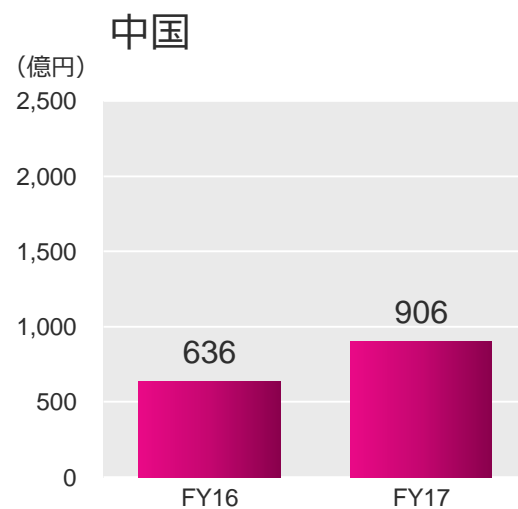
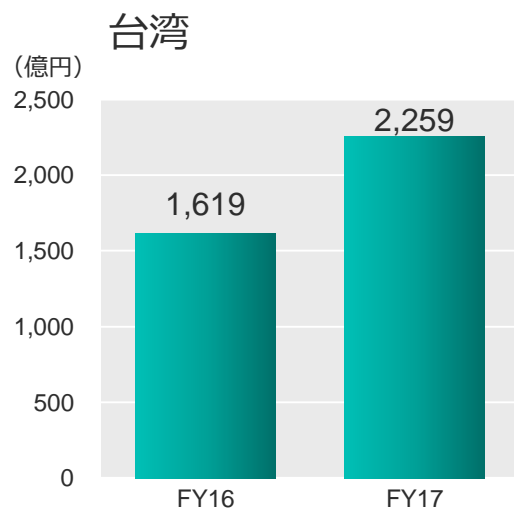
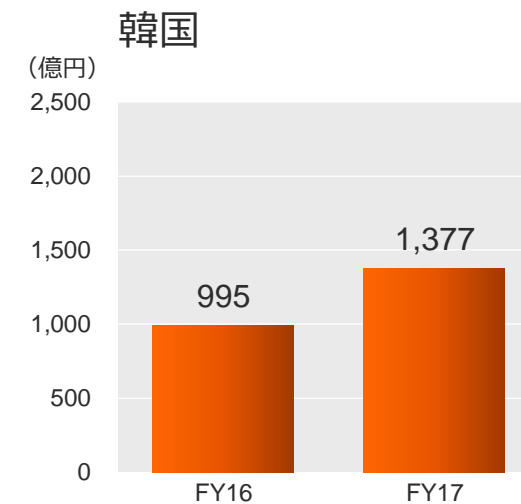
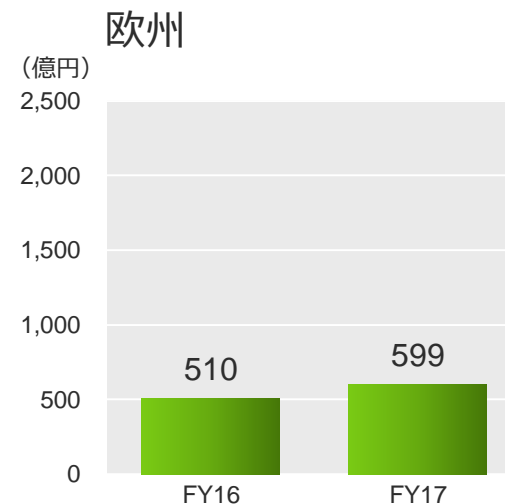
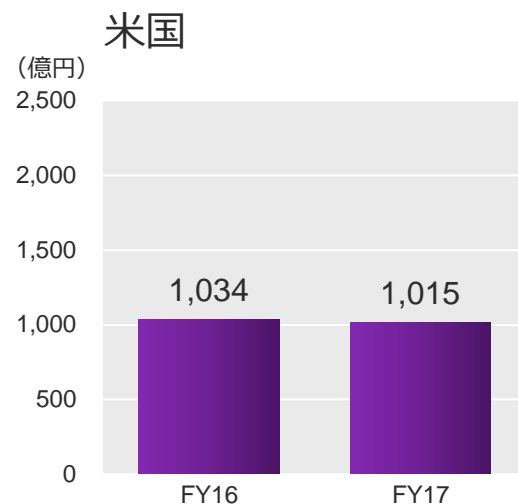
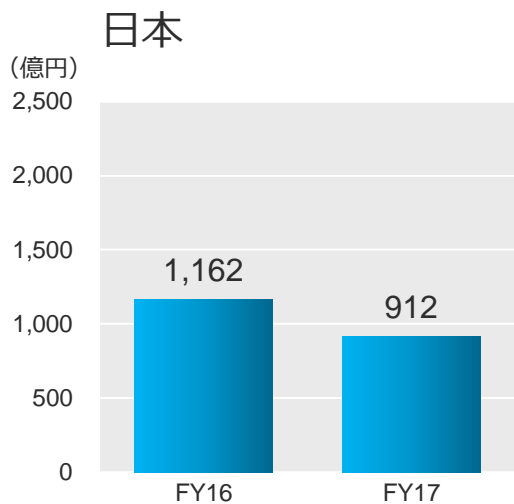
売上構成比率



参入市場とシェアの拡大により SPEのセグメント売上とセグメント利益率は過去最高を記録

1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

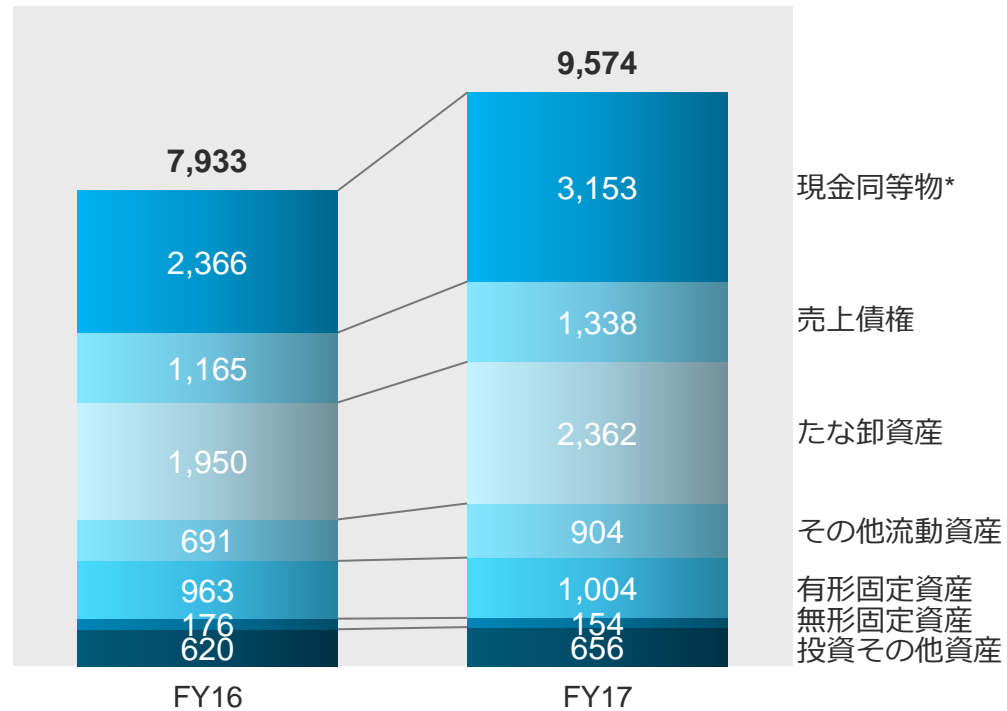
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

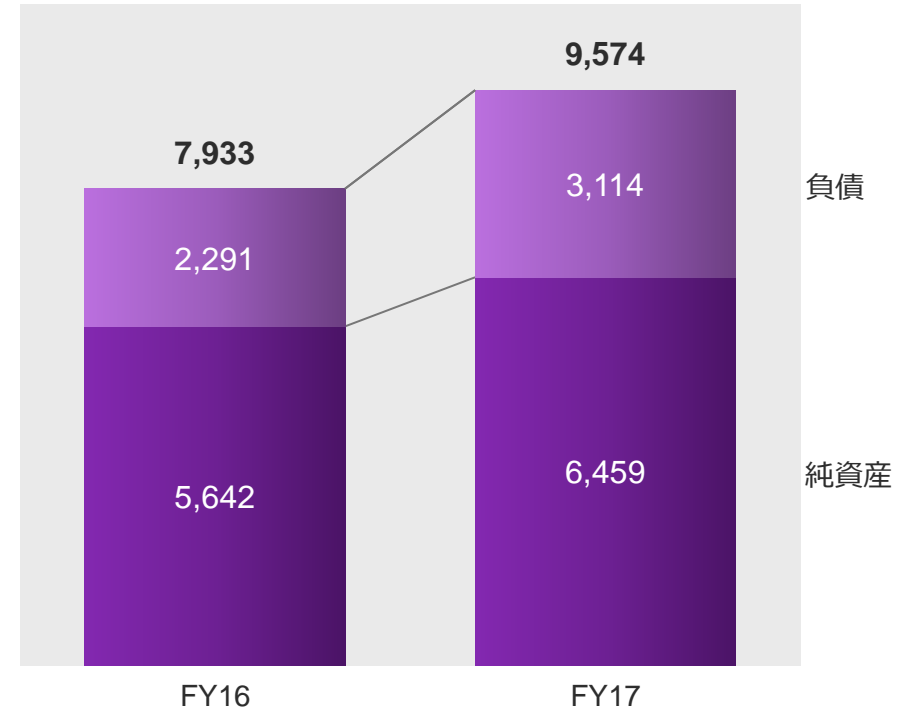
資産

(億円)



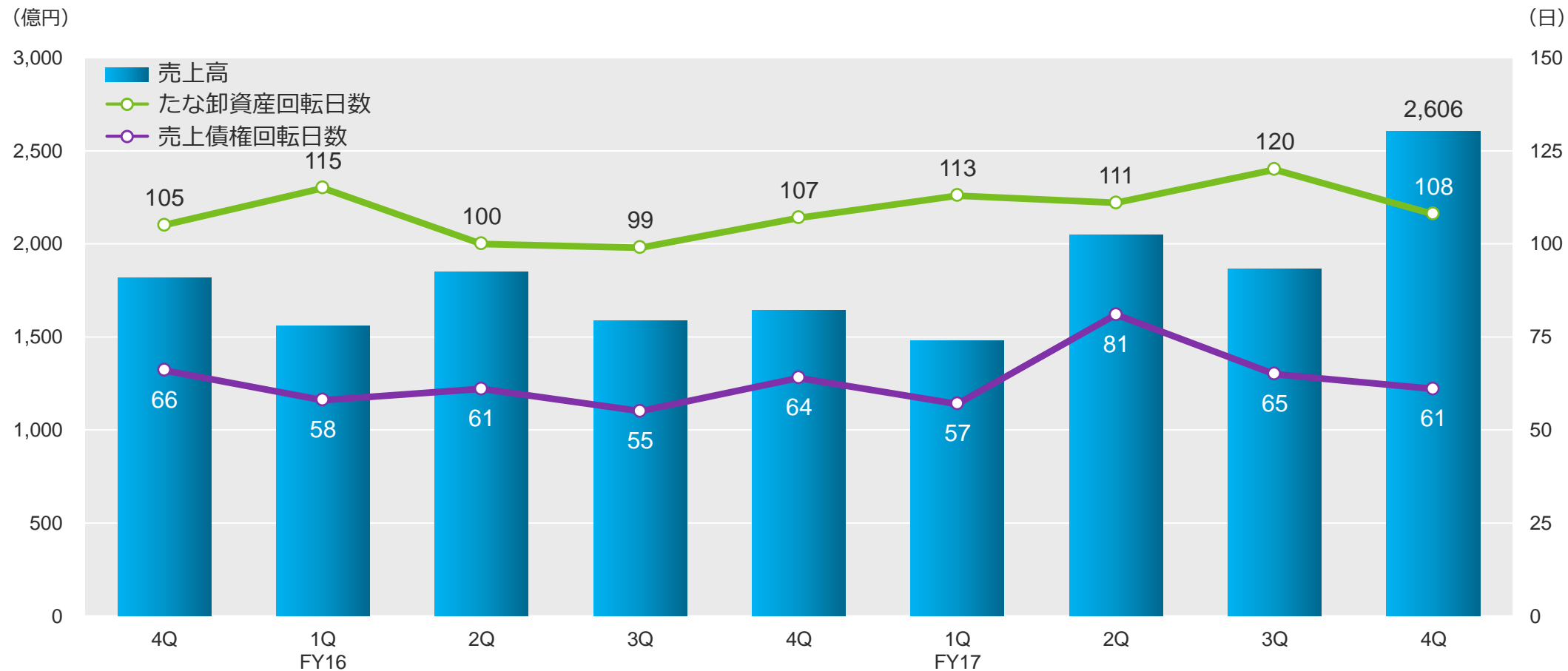
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

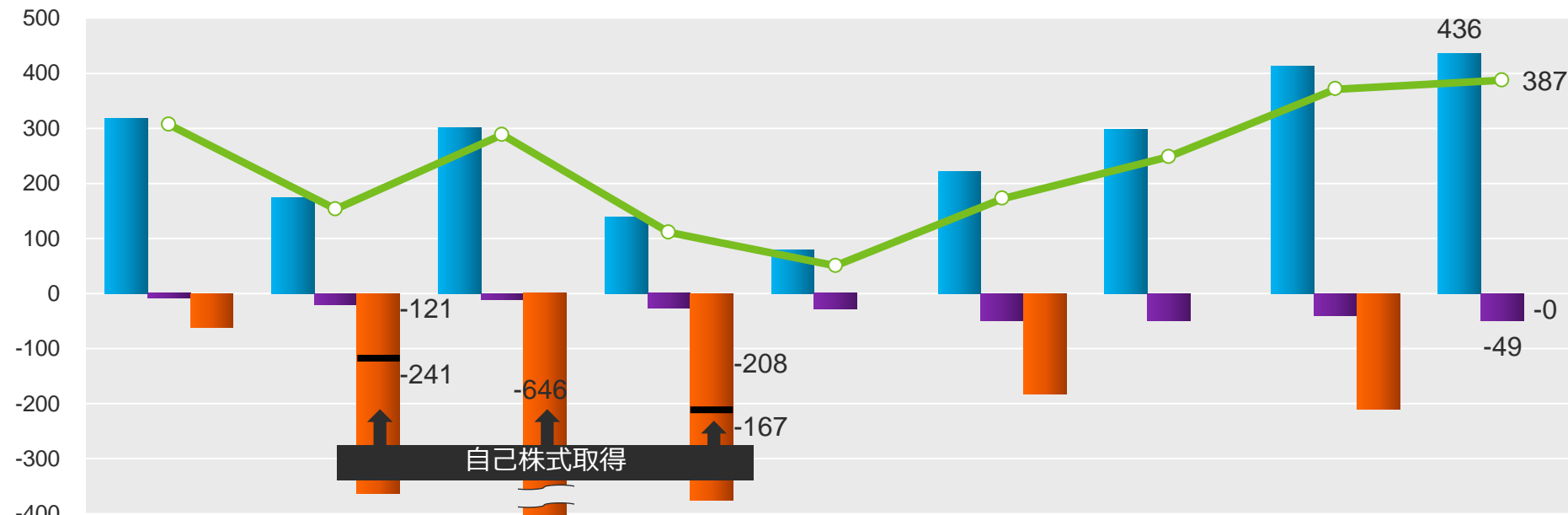
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	4Q FY15	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17	2Q	3Q	4Q
■ 営業キャッシュ・フロー	317	173	301	138	79	221	298	413	436
■ 投資キャッシュ・フロー*	-9	-20	-12	-27	-29	-49	-49	-41	-49
■ 財務キャッシュ・フロー	-62	-363	-646	-375	0	-183	0	-210	-0
● フリーキャッシュ・フロー**	307	153	288	111	50	172	248	371	387
手元資金残高***	3,176	2,989	2,607	2,338	2,366	2,309	2,556	2,772	3,153

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

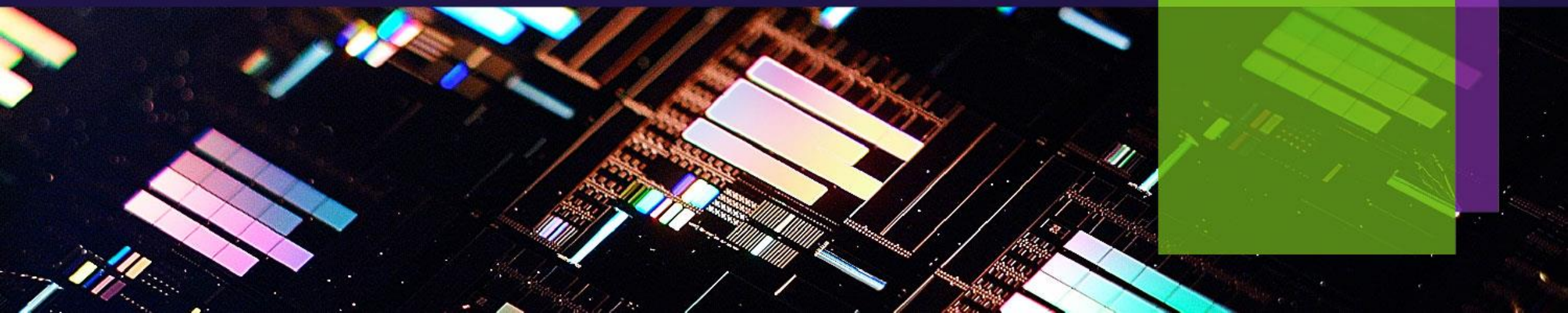


事業ハイライトおよび業績予想

2017年4月28日

河合 利樹

代表取締役社長・CEO



2017年3月期 事業ハイライト

- 当社参入市場が半導体前工程装置(WFE)*市場の5割に拡大
 - エッチング、成膜、洗浄市場の需要増加
- さらなる市場成長を見据え、先行投資を実施
 - 次世代技術の開発強化と増産対応
- 事業・製品競争力の向上
 - SPE**注力分野（エッチング・熱処理成膜・洗浄装置）のシェア向上
 - FS***事業の売上高2,080億円、前期比12%増加
 - FPD****事業の収益性改善に向けた施策が進捗

*半導体前工程装置(WFE: Wafer Fab Equipment)：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
半導体前工程装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

SPE: 半導体製造装置 *FS: フィールドソリューション ****FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

2017年3月期 製品別ハイライト

- エッチング装置（シェア23%、前年比+2pts）
 - 市場拡大とシェア向上で売上前年比13%増加
 - 先端メモリを中心に当社製品の採用が進む
 - DRAM：パターンング一括エッチング、配線工程、HARC*工程
 - NAND：3D NANDの素子分離（スリット）HARC工程
- 熱処理成膜装置（シェア59%、前年比+5pts）
 - 3D NANDで当社バッチ装置の採用が進む
 - セミバッチALD装置NT333™の売上前期比2倍
- 洗浄装置（シェア20%、前年比+2pts）
 - 枚葉・バッチの採用工程拡大

*HARC（High Aspect Ratio Contact）工程：高度な加工技術を要する深穴形成工程



プラズマエッチング装置
Tactras™



ALD装置
NT333™



枚葉洗浄装置
CELLESTA™ -i

2017年3月期 製品別ハイライト

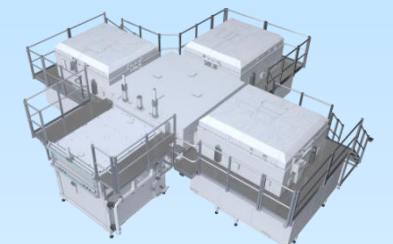
- コータ/デベロッパ (シェア90%)
 - 先端ロジック・メモリともに圧倒的な製品競争力維持
 - すべてのEUV*露光機に当社製品が採用予定
- テストシステム
 - 3D NAND/FOWLP**向けに売上拡大 (売上前期比3倍)
- FPD製造装置
 - 中小型向け新製品PICP™***エッチング装置の売上大幅拡大
 - 大型向けにもPICP™エッチング装置を投入
 - 第10.5世代のビジネス拡大



コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



マルチセルテストシステム
Cellcia™



FPDプラズマ
エッチング/アッシング装置
Impressio™

*EUV: 極端紫外線 **FOWLP: 半導体パッケージの新技术 ***PICP: パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

2018年3月期 事業環境および業績予想

半導体前工程装置(WFE)市場の展望

将来の成長ドライバー

PC・インターネット
モバイル
+
VR/AR*・IoT・AI**
機械学習・ビッグデータ
自動運転・個別化医療

WFE市場は

\$40B以上に成長

先端ロジック・メモリ向け
とともに投資拡大

半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

*VR/AR: 仮想現実/拡張現実 **AI: 人工知能

事業環境（2017年4月時点での見方）

▶ 半導体設備投資

CY2017の半導体前工程装置(WFE)の設備投資額は、次世代3D NANDおよび先端ノード向けロジック投資の立ち上がりにより、前年比10%程度の成長を予想

▶ FPD設備投資

CY2017のTFTアレイ工程*向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

*TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

- NAND：前年比25-30%の市場成長を予想
 - 牽引役：データセンタ向けSSD需要
 - 設備投資：6X/7X層数世代向けが8割、2017年末に月産70万枚の3D NAND生産設備を見込む
 - 事業機会：市場拡大とシェア向上、次世代9X/12X層数世代での工程拡大に注力
- DRAM：5-10%の増加
 - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比1GBの増加、サーバの搭載容量も30%増加
 - 設備投資：1Xnm世代向け設備投資が6割以上
 - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準を予想
 - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
 - 設備投資：最先端10/7nm世代向けが7割
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

四半期 受注額・受注残高

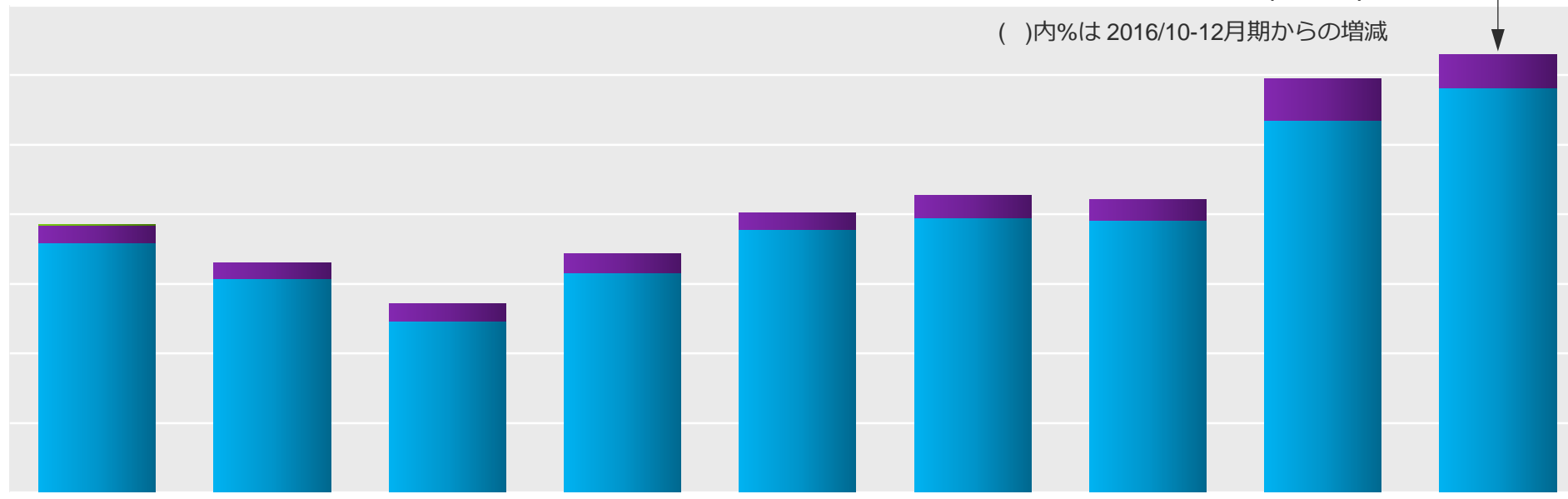
2017/1-3月期

SPE	2,904億円	(+9%)
FPD	241億円	(-21%)
合計	3,145億円	(+6%)

(億円)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

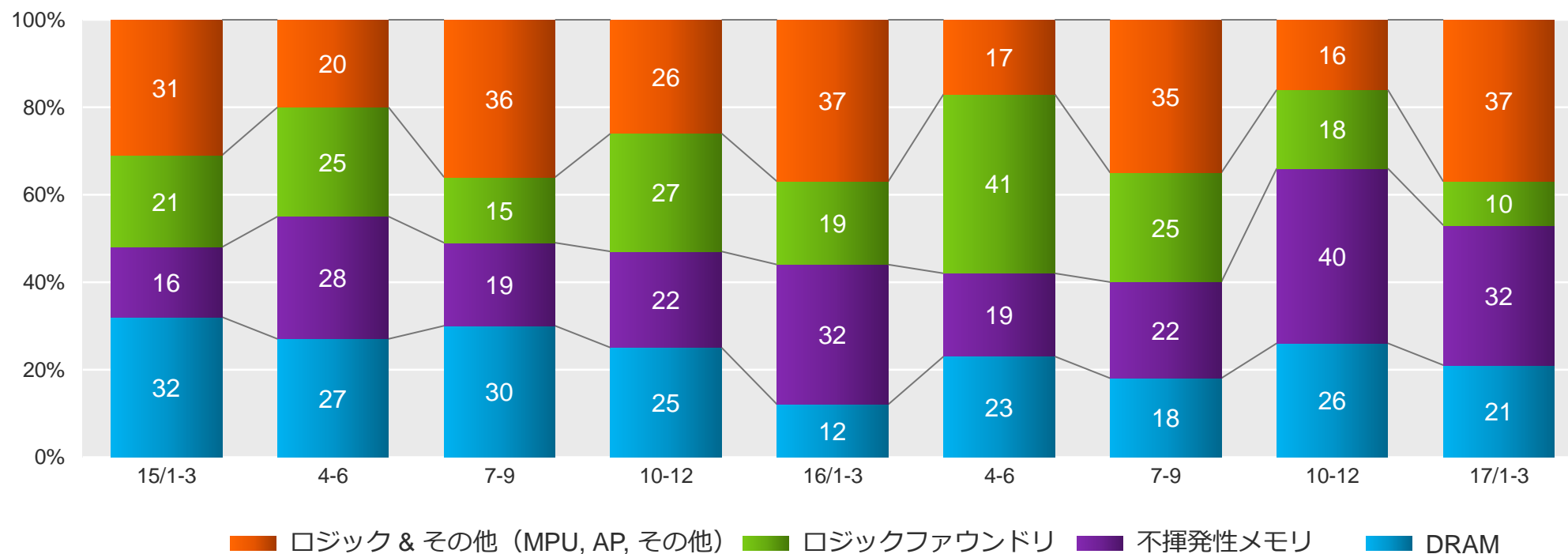
()内%は 2016/10-12月期からの増減



	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9	10-12	17/1-3
■ SPE受注額	1,792	1,534	1,228	1,579	1,886	1,974	1,956	2,671	2,904
■ FPD受注額	126	118	125	139	122	159	150	304	241
SPE受注残高	2,533	2,664	2,126	2,241	2,632	3,299	3,294	4,172	4,641
FPD受注残高	316	333	376	399	374	363	429	665	736

2017年1-3月期は、2四半期連続の過去最高受注額となる

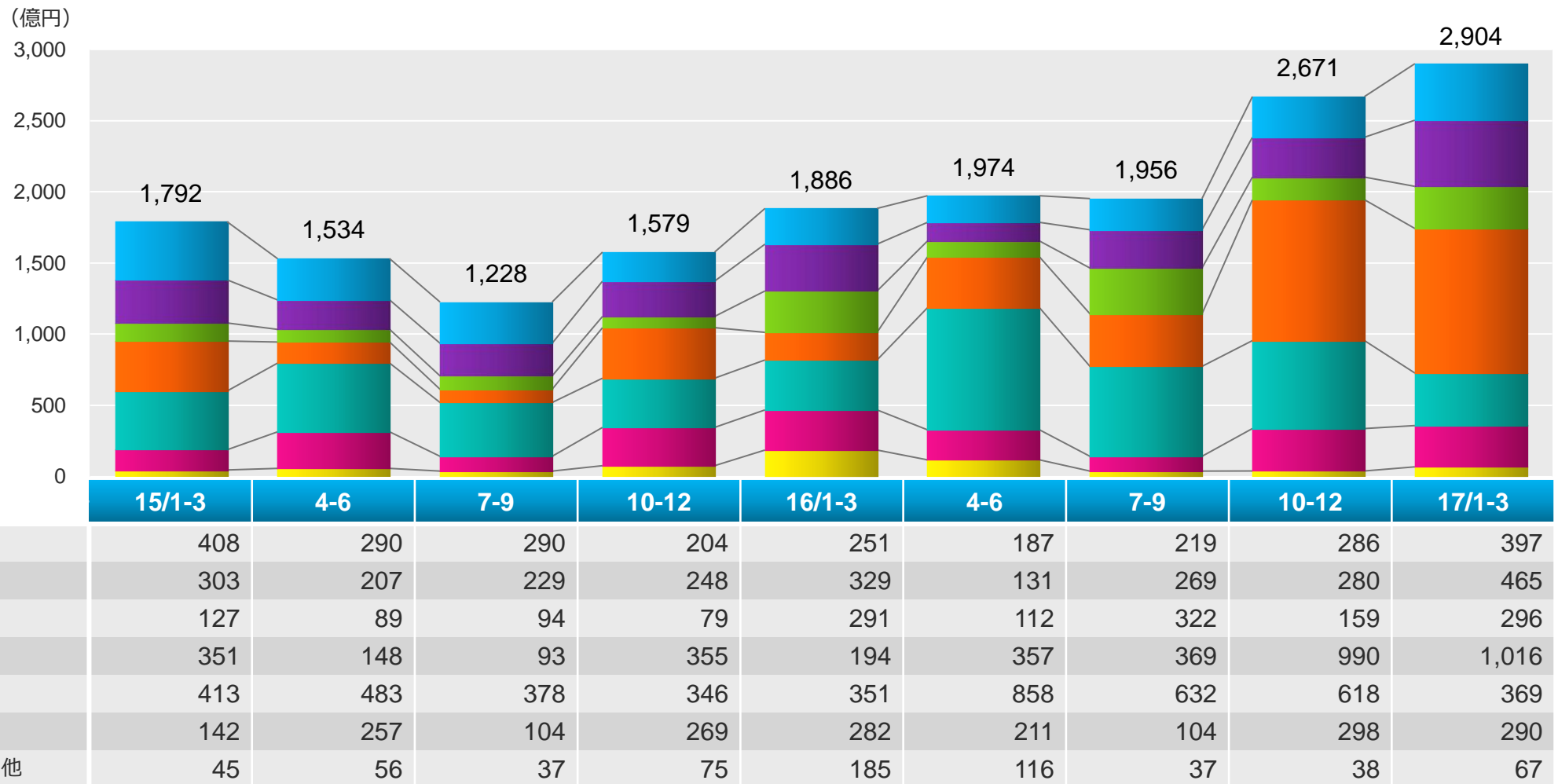
SPE受注アプリケーション別構成比



2017年1-3月期は、欧米および韓国のロジックが増加

グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額



2017年1-3月期は、国内のメモリおよび欧米のロジック向けが増加

2018年3月期 業績予想

2018年3月期 業績予想

(億円)

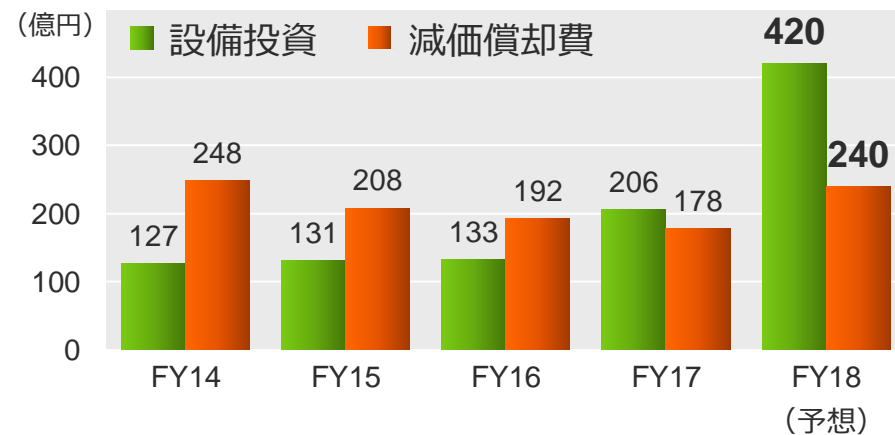
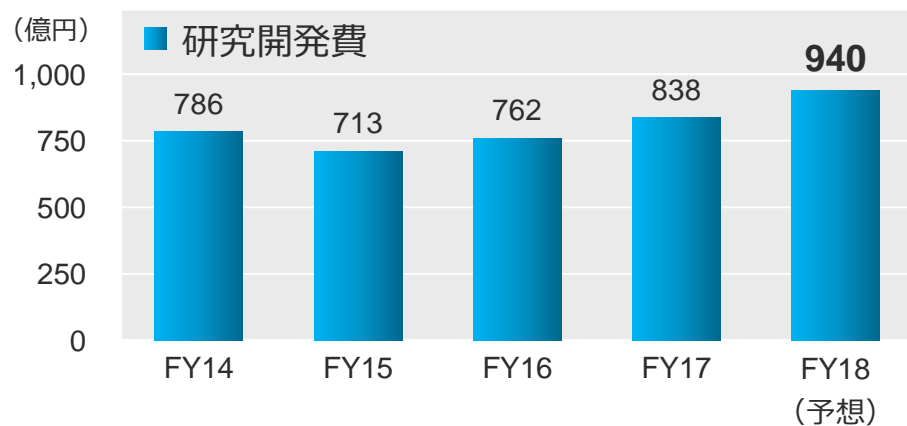
	FY2017 (実績)	FY2018 (予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	7,997	4,800	5,000	9,800	+22.5%
SPE	7,498	4,510	4,590	9,100	+21.4%
FPD	493	290	410	700	+41.7%
売上総利益 下段：売上総利益率	3,222 40.3%	2,020 42.1%	2,100 42.0%	4,120 42.0%	+897 +1.7pts
販管費	1,665	980	980	1,960	+294
営業利益 下段：営業利益率	1,556 19.5%	1,040 21.7%	1,120 22.4%	2,160 22.0%	+603 +2.5pts
税前利益	1,491	1,040	1,120	2,160	+668
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	790	840	1,630	+477
1株当たり当期純利益 (円)	702.26	481.48	511.96	993.44	+291.18

市場成長以上の売上拡大、2期連続の過去最高益を見込む

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

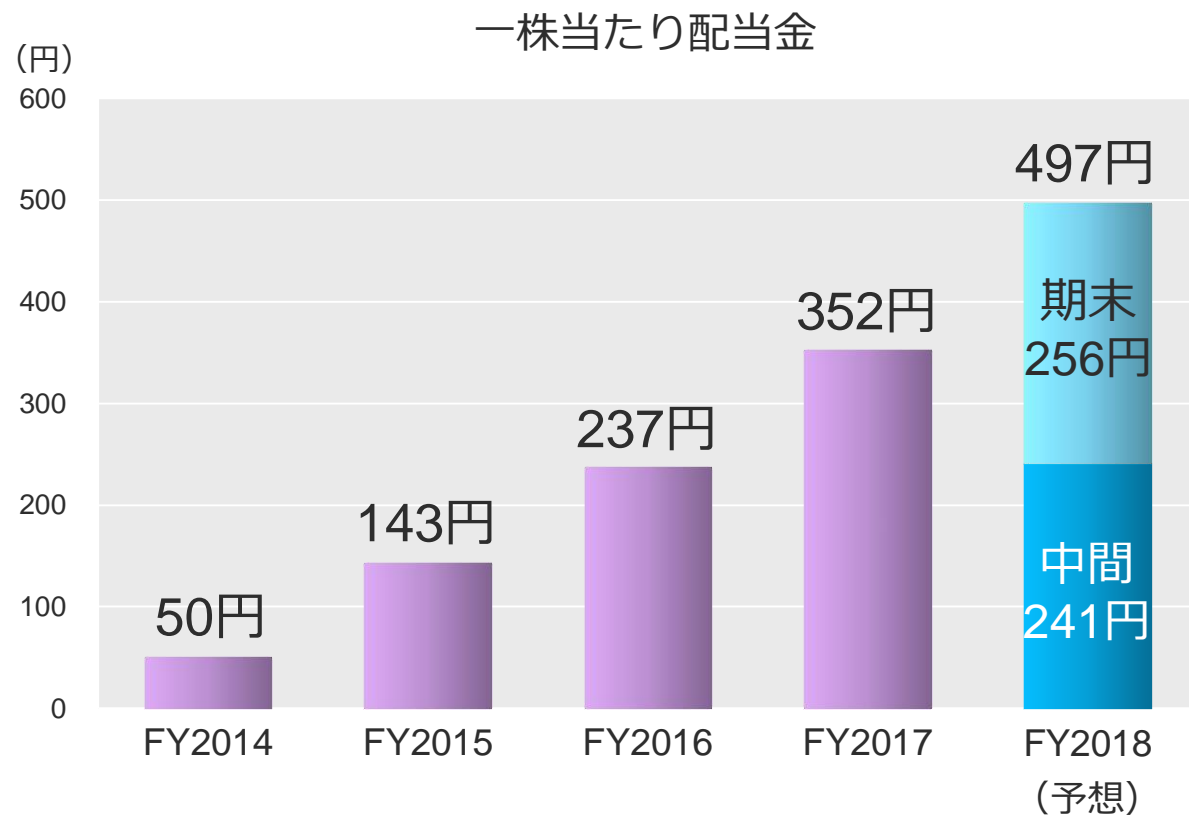
研究開発費・設備投資計画

- 売上高 9,800億円（前期比1,802億円増加）
 - 先端ロジック（10/7nm世代）、次世代3D NAND・DRAM向け需要拡大
- 開発費 940億円（前期比101億円増加）
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 420億円（前期比213億円増加）
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資



装置市場の新たなフェーズに向けた積極的な先行投資を予定

2018年3月期 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

一株当たり配当金は、前期比40%以上の増配を予定

中長期視点での対話促進のための取り組み

- 開示項目の見直し
 - 受注実績を非開示情報とする（2018年3月期 第1四半期決算から）
- 見直しの理由
 - 中長期的な成長戦略など、当社の本質的な企業価値向上についての対話をより重視
 - 超短期の株価ボラティリティの抑制と適正な企業価値評価の推進

今後も持続的成長と適正な企業価値形成に向けた対話を促進していく

補足資料

損益状況

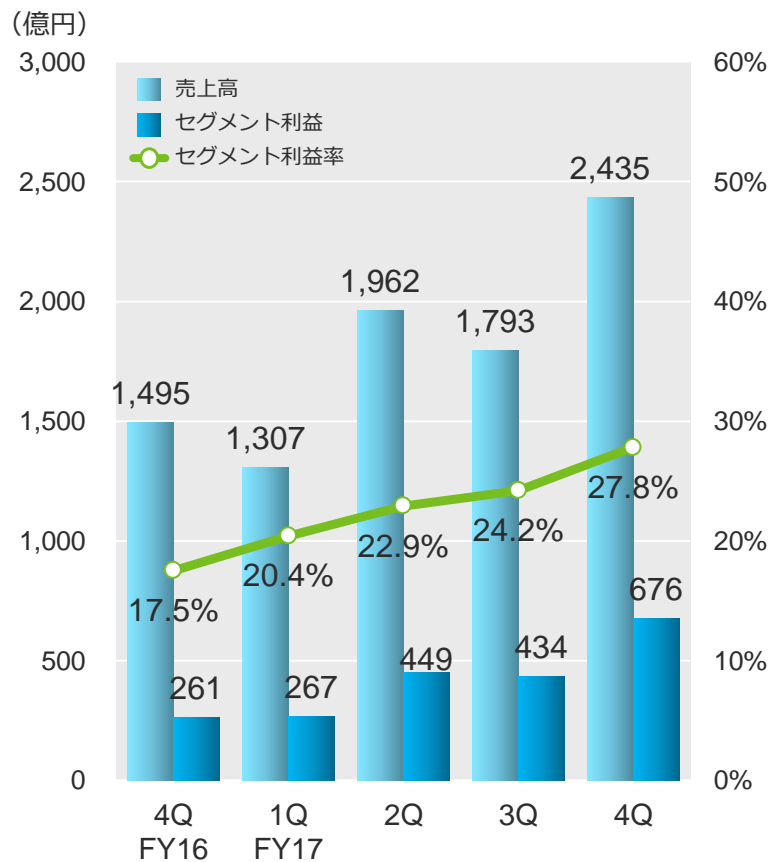
(億円)

	2016年3月期	2017年3月期					対前年4Q 増減率
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	1,642	1,479	2,047	1,863	2,606	+58.7%	
SPE	1,495	1,307	1,962	1,793	2,435	+62.9%	
FPD	146	170	84	68	170	+15.9%	
その他	0	1	1	1	1	---	
売上総利益	691	573	813	729	1,106	+60.1%	
下段：売上総利益率	42.1%	38.7%	39.7%	39.1%	42.5%	+0.4pts	
販管費	391	352	434	387	491	+25.7%	
営業利益	300	220	379	341	615	+105.0%	
下段：営業利益率	18.3%	14.9%	18.5%	18.3%	23.6%	+5.3pts	
税前利益	238	161	382	332	614	+158.2%	
親会社株主に帰属する 当期純利益	186	126	292	259	472	+153.5%	
研究開発費	203	177	220	191	248	+22.0%	
設備投資額	56	38	55	41	71	+26.4%	
減価償却費	49	39	42	45	50	+2.3%	

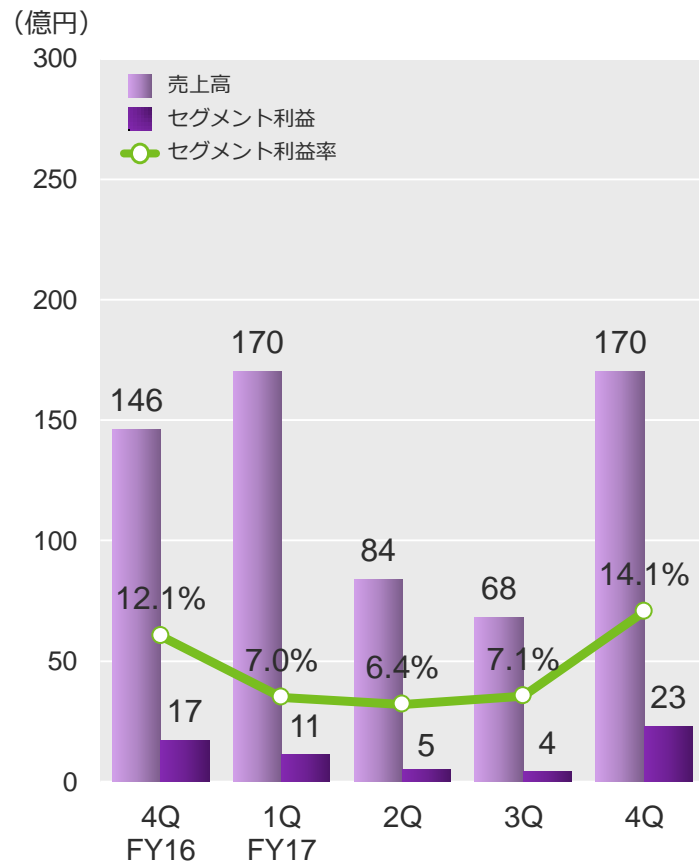
1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報

SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

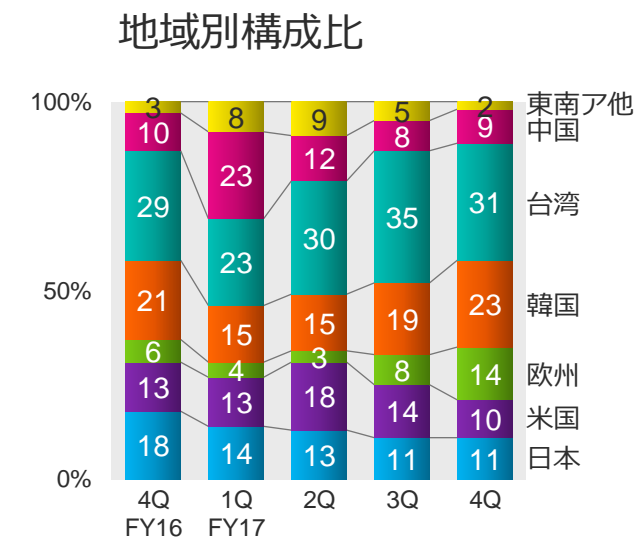
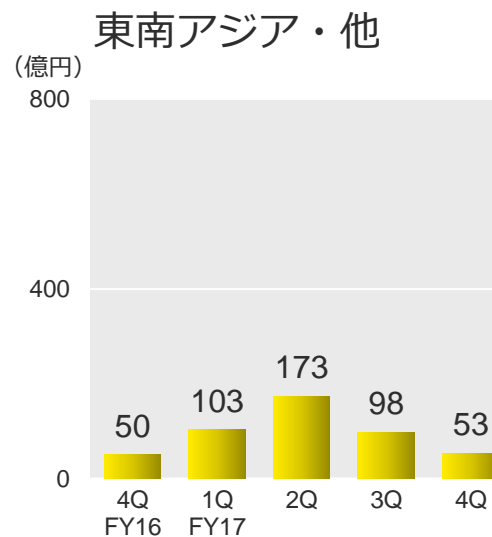
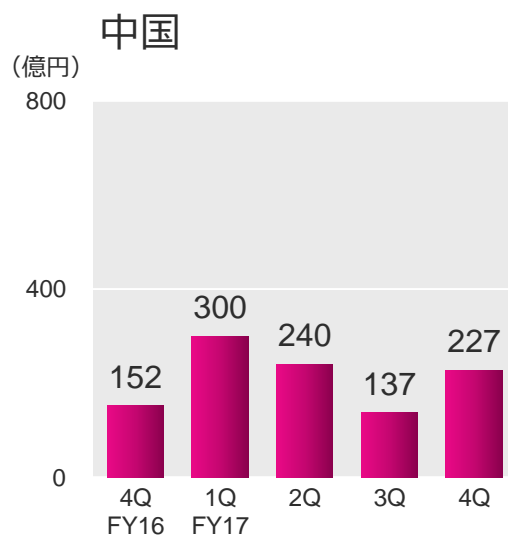
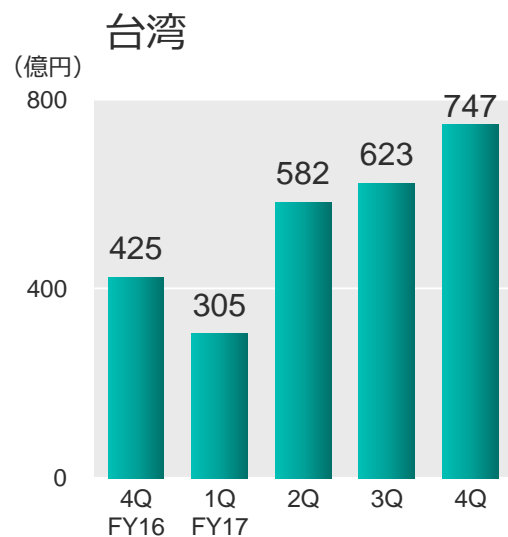
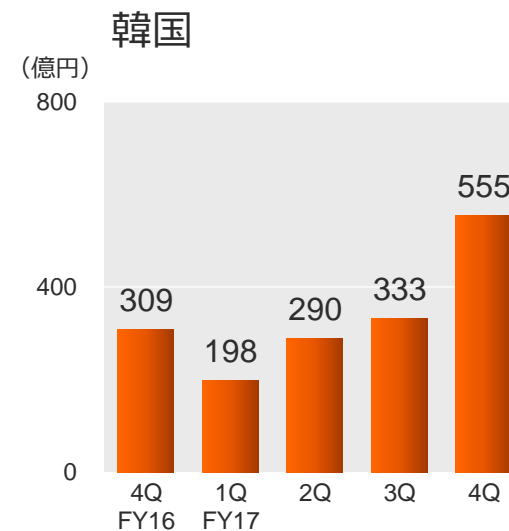
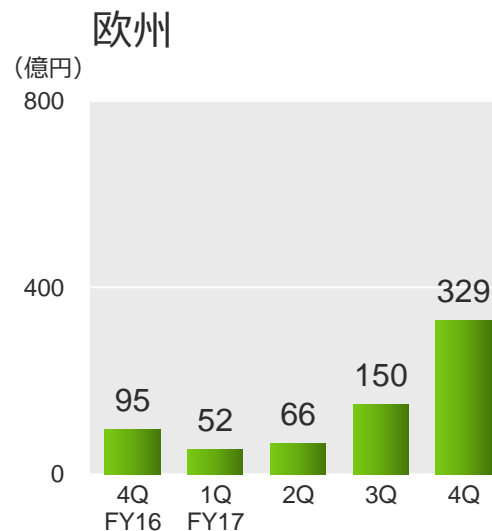
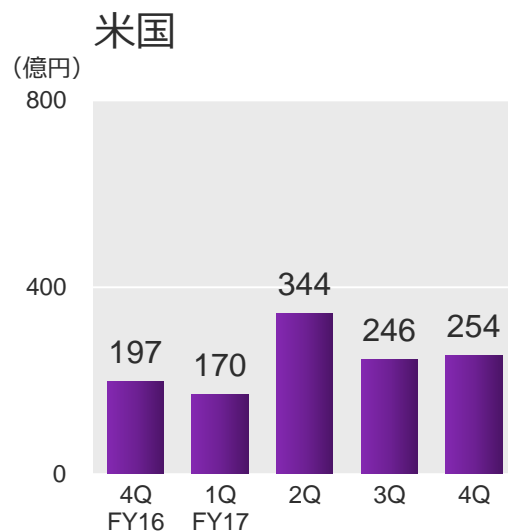
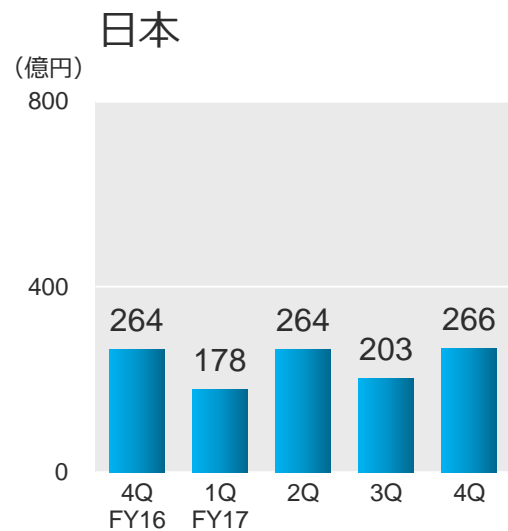


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

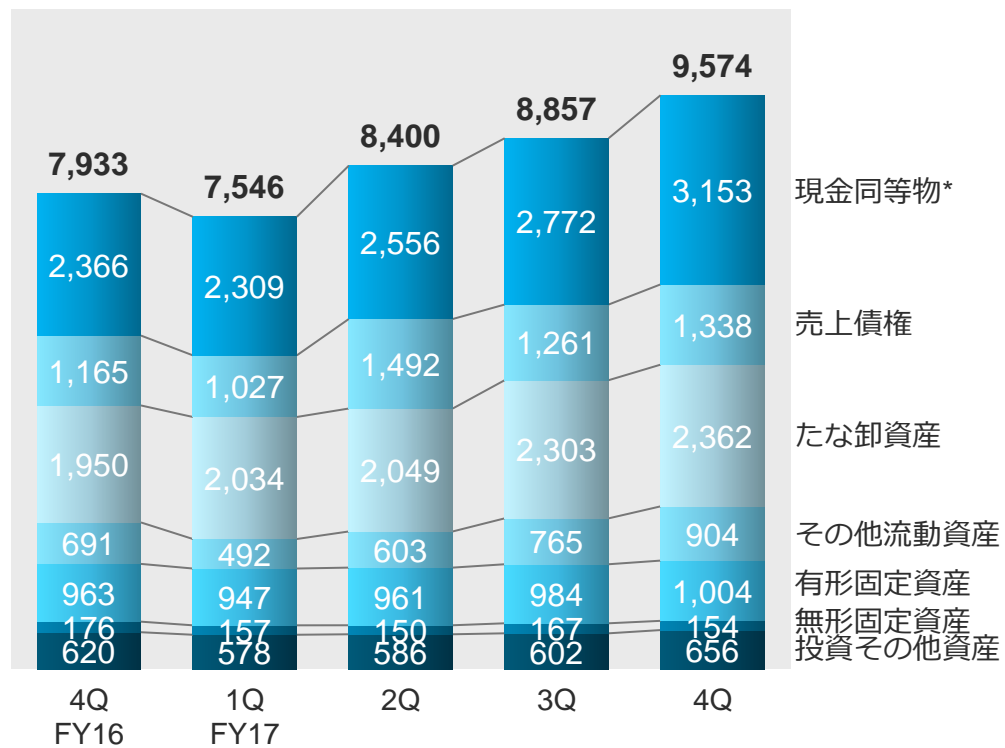
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

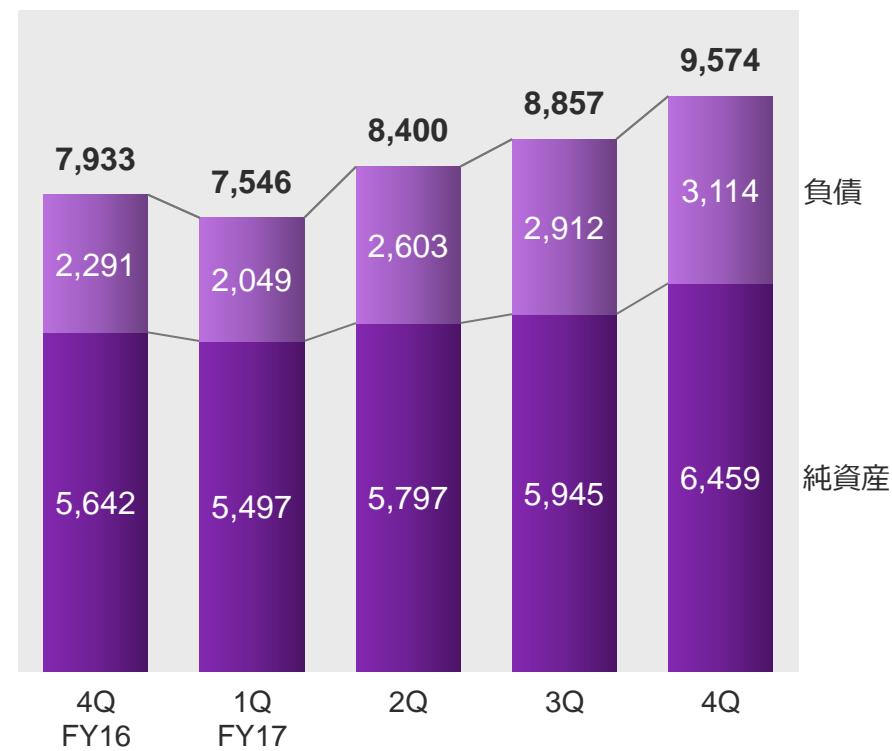
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

従業員数

(人)

		2016年3月末	2017年3月末
	日本	7,060	7,288
	米国	1,586	1,655
	欧州	435	448
	アジア	1,548	1,850
合計		10,629	11,241

製品区分変更に伴うシェア実績の調整（エッチング・洗浄装置）

調整前

市場シェア	CY2014	CY2015	CY2016
エッチング装置	26%	19%	21%
洗浄装置 (ドライ洗浄装置含む)	24%	23%	25%

調整後

市場シェア	CY2014	CY2015	CY2016
エッチング装置 (ドライ洗浄装置含む)	28%	21%	23%
洗浄装置	19%	18%	20%

- CY2016から、ドライ洗浄装置をエッチング装置に区分変更したことに伴い、エッチング装置および洗浄装置のCY2014、CY2015、CY2016のシェア実績を調整しました。

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ